

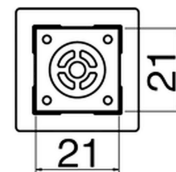
# Heißluftdüse BGA 20×20mm - Hakko N51-19

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>HK-N51-19</b>	<b>Hersteller</b>	<b>Hakko</b>
<b>Hersteller-Nr.</b>	<b>N51-19</b>	<b>EAN</b>	<b>4962615047534</b>

Spezielle BGA-Heißluftdüse mit 20×20mm Öffnung für die Hakko Heißluft-Rework-Stationen FR-810 und FR-810B. Konzipiert für das präzise Erhitzen von Ball-Grid-Array-Bauteilen beim Löten und Entlöten.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Ausführung	<b>TEC</b>
Gewicht	<b>0.0099 kg</b>
Hinweis	<b>Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz</b>
Ursprungsland	<b>Japan</b>
Zolltarifnummer	<b>85159080</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

### Überblick

Die Hakko N51-19 ist eine Präzisions-Heißluftdüse, die speziell für das Rework von BGA-Bauteilen (Ball Grid Array) entwickelt wurde. Mit ihrer 20×20mm großen Öffnung sorgt diese Düse für eine fokussierte, gleichmäßige Wärmeverteilung und eignet sich ideal zum Löten und Entlöten von Ball-Grid-Array-Gehäusen mit feinem Raster auf Leiterplatten.

### Hauptmerkmale

- BGA-optimiertes Düsendesign mit 20×20mm Öffnung
- Kompatibel mit den Heißluft-Rework-Stationen FR-810 und FR-810B

- Präzise Wärmekonzentration für kontrollierte Temperaturprofile
- Robuste Bauweise für wiederholte Rework-Zyklen
- Einfache Montage und Demontage

## Technische Daten

<b>Düsentyp</b>	BGA-Heißluftdüse
<b>Öffnungsgröße</b>	20×20mm
<b>Kompatible Stationen</b>	Hakko FR-810, FR-810B
<b>Herkunftsland</b>	Japan

## Anwendungen

Ideal für das Rework und die Reparatur von BGA-Bauteilen auf Leiterplatten, darunter Mikroprozessoren, Speichermodule und weitere Ball-Grid-Array-Gehäuse mit feinem Raster, in der Elektronikfertigung und in Reparaturbetrieben.